

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-07

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：电话会议
参与单位名称	银华基金、华夏基金、平安基金、南方基金、富国基金、招商基金、融通基金、海富通基金、汇丰晋信基金、创金合信基金、宝盈基金、新华基金、圆信永丰、华泰保兴、鑫元基金、富安达基金、九泰基金、国联基金、新疆前海联合、银河基金、国信资管、华泰资管、招银理财、宁银理财、建信保险、国寿养老、明达资产、仁桥资产、循远资产、银叶投资、宽投资产、和沅资产、熙山资本、罗爵资产、同威投资、明己投资、前海华杉投资、盟洋投资、中略投资、鲲鹏恒隆、鑫融长弘、玄卜投资、青骊投资、川流基金、盛熙基金、敦成基金、辰翔基金、鸿运基金、睿澜基金、恒邦兆丰基金、兴证投资、云溪基金、君联资本、修能资本、华夏久盈、IGWT Investment、陕西能源、中信证券、国泰海通证券、国信证券、中泰证券、开源证券、国金证券、华福证券、天风证券、东财证券
时间	2026 年 8 月 17 日 15:00—16:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长：许文焕 董事：高健 董事会秘书：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	首先介绍了民德电子 2026 年半年度经营情况，随后介绍了晶圆代工行业发展趋势及公司经营策略，最后对投资者关心的问题进行了解答。 一、公司上半年经营情况介绍 （一）2026 年半年度主要财务情况 1、2026 年上半年，公司实现营业总收入 15,079.97 万元，较上年同期增加 2,072.56 万元，同比增长 15.93%，2025 年 11 月公司转让了君安技术全部股权，剔除去年同期君

安技术公司收入后，公司上半年收入同比增加 4,144.11 万元，同比增长 37.89%。

公司营业收入主要来源于以下三个业务板块：

1) 功率半导体业务板块，2026 年上半年实现营业收入 5,368.86 万元，同比去年上半年增长 310.77%，环比去年下半年增长 172.48%。功率半导体业务收入在整个上市公司收入占比，今年上半年占比为 35.60%，去年下半年占比为 11.38%，收入占比提升明显，全年占比有望进一步提升。

2) AiDC 业务板块，2026 年上半年实现营业收入 6,350.02 万元，同比减少 37.39%。一方面是公司在去年 11 月份出售了君安技术股权，原合并范围内子公司君安技术不再纳入合并报表范围，对本报告期营业收入同比数据产生一定影响；另一方面，受电子元器件等原材料价格大幅上涨的影响，公司对 AiDC 产品物料清单进行优化调整，部分海外客户需对产品重新进行验证，对产品交付节奏和上半年收入造成阶段性影响，目前客户的产品验证工作正在有序推进中，验证完成后产品交付进度将逐步恢复。

3) 电子元器件分销业务板块，2026 年上半年实现营业收入 3,361.09 万元，同比增长 115.78%，主要是因为今年上半年电子元器件市场景气度高，分销业务有所增长。

2、2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,242.09 万元，较上年同期亏损增加 6,273.91 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,397.74 万元，较上年同期亏损增加 1,251.00 万元；主要原因系：（1）上年同期公司完成对广芯微电子的控股收购，根据会计准则核算确认了五千多万的投资收益（属于非经常性损益），本报告期无此项收益；（2）控股子公司广芯微电子虽收入较上年同期大幅增长，但整体产出规模仍较小，而固定资产折旧摊销及人员等固定成本有所增加，导致广芯微电子仍处于亏损状态，且净利润同比减少；（3）母公司 AiDC 业务收入下降，净利润也同比有所减少。

3、2026 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额-3,541.34 万元，较上年同期净流出增加 448.22 万元，主要原因系广芯微电子尚处于产能爬坡阶段，其生产经营活动产生的支出金额大于收入金额。

（二）功率半导体业务进展

1、晶圆代工厂广芯微电子

广芯微电子上半年收入 5,204.22 万元，同比增长 101.44%，环比去年下半年增长 42.23%。今年以来，广芯微电子一直处于满产满销状态，在手订单充足，并于今年 6 月

开始上调代工价格。同时，为了更好地满足客户产能的增加需求，广芯微电子也通过多种渠道开展融资工作，积极推进良性扩产，广芯微电子今年已完成 1.65 亿元社会化股权融资，陆续收到地方政府税收返还等政策性资金近 1 亿元，并拟与光大银行等金融机构签订长期固定资产项目贷款超 1.5 亿元。

广芯微电子已陆续与多家供应商签订设备采购合同，并在逐步交付中，产能预计会在今年的四季度和明年上半年集中释放。产品开发方面，除已量产的 MFER、VDMOS、TVS 产品外，公司正积极开发更多的高端特色产品。

2、设计公司广微集成

广微集成上半年收入 2,143 万元，同比增长 206.83%，环比去年下半年增长 121.63%。广微集成主要产品 MOS 场效应二极管产品（MFER）月销量从 2025 年初 1 千多片大幅提升至目前超 1.7 万片，创历史最高单月出货水平，广微集成于 7 月份开始对产品报价进行上调，且近两个月均实现单月盈利。广微集成也在不断开发新产品，并在推进成品销售的工作，广微集成的销售额和盈利能力有望进一步提升。

3、重要参股企业

1) **晶圆原材料企业晶睿电子：**公司持有晶睿电子 20.76%的股权，2026 年上半年，晶睿电子的收入较上年同期增长 16%，延续自 2025 年底以来满产满销状态，并创单月营收历史新高；晶睿电子产品结构持续优化，上半年其整体毛利率已实现转正，产品从 7 月份开始涨价。晶睿电子今年完成约 2 亿元股权融资，新建的单晶棒项目预计 2027 年初投产，投产后其单晶棒原材料供应将得到进一步保障。晶睿电子是国内为数不多具备 SOI 量产能力的厂商，具备自主知识产权，产品在具身智能传感器（惯性传感器、压力传感器等）和光电路交换机 OCS（MEMS 微镜阵列）领域陆续验证通过并稳步放量。

2) **特种工艺晶圆代工厂芯微泰克：**2026 年上半年，芯微泰克收入与上年同期基本持平，产品结构在不断优化，8 英寸硅基薄片/超薄片背道工艺产品增长较快，重金属掺杂等特色工艺产品毛利率同比有所提升，已引进了多家国内头部客户。

二、晶圆代工行业发展趋势及公司经营策略

晶圆代工行业整体已转入非常景气的周期。从全球晶圆制造来看，过去 4-5 年低谷期是因为市场需求增长没有超过生产效率提升的速度，从而导致供过于求。从去年下半年开始，由于 AI 数据中心、电网升级等领域的带动，市场需求呈现高速增长态势，其

中内存涨价 10 倍以上，电容、电阻、二极管、三极管等也都在涨价。受制于晶圆制造的复杂程度，以及出于供应链安全考虑而带来的本土化布局，新增产能会受到制约，需求远大于供给，未来 3~5 年将是晶圆代工行业的景气周期。全球产能将优先向高端产品倾斜，高端产品有望获得更高的溢价；随着逐级传导，在产能挤压及市场提升的情况下，功率半导体、电子元器件等产品也会有较大的上行空间，都将受益于本轮景气周期。

对于公司来说，将以“扩产能、调结构”作为公司晶圆代工厂未来 3-5 年的经营策略。随着设备工艺的提升，6 英寸线已能满足大多数功率产品生产要求，而且我们目前已量产产品的良率已经做到业界最高水准；公司在多工艺平台搭建完成后，将在不断提升产能的同时，往高压、大功率产品等高端产品方向不断优化，以满足数据中心、电网升级改造等附加值更高的应用需求。

三、问答交流

1、晶圆厂一期产能扩产设备进场节奏如何？什么时候能形成有效产能？

答：公司已陆续签订了扩产至 6 万片月产能的设备合同，且部分设备已开始进场；同时，公司也在和多家供应商洽谈扩产至 10 万片的设备，争取以最快速度敲定完成。晶圆厂的产能预计今年四季度和明年上半年开始会有明显释放，具体视设备进场和调试进度而定。

2、公司后续涨价节奏和空间如何，客户接受度如何？

答：公司主要根据市场情况，随行就市调整价格。目前已有上游硅片厂商表达了四季度再次涨价的意愿，广芯微电子将具体视上游情况和产品结构优化情况决定是否跟进；从市场端看，预计未来三年功率半导体将处于景气周期，价格依然有较大的上行空间。

公司不同品类产品涨价幅度会有差别，在稳定保供的情况下客户接受度较好，目前的价格相比 2023 年初仍然处于低位。

3、晶圆代工厂目前的产品结构如何？新增产能是否往高端倾斜？

答：广芯微电子目前约 40%产能用于生产 MFER 产品，剩余大部分生产 VDMOS 产品，少量量产 TVS 产品。未来，广芯微电子将不断优化产品结构，新增产能聚焦高压、大功率应用场景，主要生产特高压 VDMOS、IGBT 及 700V 高压 BCD 等高端产品。

5、公司特高压 VDMOS、IGBT 和 700V 高压 BCD 产品目前验证节点如何？

答：目前，公司特高压 VDMOS 产品已进入量产阶段，IGBT 和 700V 高压 BCD 产品处于客户流片与导入阶段，产品的核心工艺环节都已完成验证，现有设备已具备量产能力。

6、定增 10 亿元中 7 亿元投资对应多少产能？

答：公司定增中 7 亿元拟用于 6 英寸功率半导体晶圆代工产线扩产，提升晶圆代工产能，达产后，预计将新增适用于高压、大功率领域的特高压 VDMOS、IGBT 和 700V 高压 BCD 等产品的晶圆代工产能 6 万片/月。

7、晶圆代工厂二期项目如何规划？

答：广芯微电子项目占地约 150 亩，一期项目规划为月产 10 万片 6 英寸硅基晶圆加工产能，已使用建设用地 100 亩，但整个厂区共用的配套基础设施已全部完成建设，预留的 50 亩地用于二期厂房建设，只需再建一栋生产厂房添加设备即可，预计比新建厂会快很多。公司将尽快推进一期项目满产，并择机启动二期项目建设。

8、广芯微电子少数股东股权未来如何规划？

答：晶圆代工厂作为公司的核心战略资产，公司将始终保持对广芯微电子的控制权。对于广芯微电子的少数股东股权，我们希望在广芯微电子实现经营性现金流或净利润转正后，通过上市公司换股发行收购剩余股权，或者利用现金回购部分股权，具体进度届时将根据广芯微电子经营情况以及和股东沟通情况确定。

9、公司上半年研发和财务费用同比增加较大、计提较大金额资产减值损失的原因，以及后续趋势如何？

答：研发费用同比增加，主要系广芯微电子随产量增长研发支出相应增加，以及公司持续推进产品研发工作、加大研发投入所致；后续公司将结合研发项目进展及实际需求，合理规划研发投入。

财务费用同比增加，主要是由于广芯微电子并表后，金融机构借款的增加导致利息支出较上年同期增加；后续公司定增完成后计划通过归还和置换部分利率较高的金融机构借款，以降低财务费用。

上半年计提的存货跌价损失金额较大，主要是由于广芯微电子仍处于产能爬坡阶段，整体产量较小，产成品单价中包含的折旧、摊销、料工费金额较大，从而导致计提的存货跌价金额较大；后续随着广芯微电子产销量不断增加、功率半导体产品市场价格提升，广芯微电子的存货跌价将逐渐减少。

	风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026-08-17